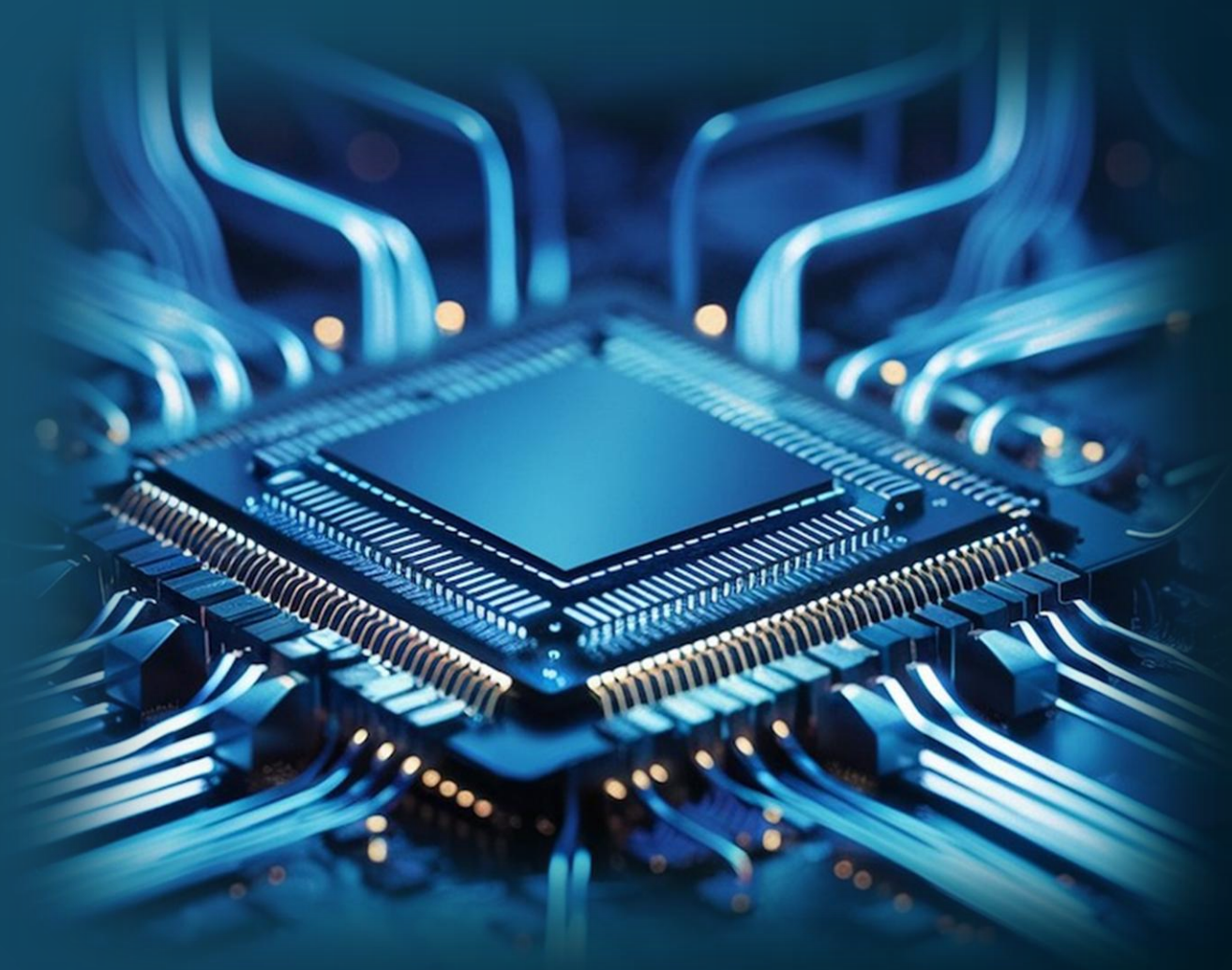




PRIORTECH

מצגת שוק הון
אפריל 2026



בין השאר בשל הטלת מגבלות תנועה או חסימת נתיבי שיט בטריטוריות בהן פועלות החברה ו/או החברות המוחזקות שלה; (ב) תלות בצדדים שלישיים וקיום הסכמים על ידי צדדים שלישיים עימם התקשרה החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות שלה; (ג) התפתחויות רגולטוריות ומדיניות ממשלתית, בעיקר בשל פעילותן חברות הקבוצה בטריטוריות ברחבי העולם ובעיקר במזרח אסיה; (ד) חוסר יציבות באזורי פעילות גלובלית והשפעת משברים פוליטיים, כלכליים וגאו-פוליטיים על תעשיית המוליכים למחצה והמתח בין ארה"ב לבין סין; (ה) ההיצע העולמי של רכיבים אלקטרוניים ויכולתן של החברות המוחזקות לרכוש רכיבים אלקטרוניים לצורך שימור היתרון התחרותי שלהן; (ו) גידול בעלויות תפעוליות; (ז) עלויות ייצור גבוהות של לקוחות אשר עלולות להביא לעיכוב ברכישת מוצרים של החברות המוחזקות; (ח) גורמי הסיכון המפורטים בדוח השנתי של החברה לשנת 2025 שפרסמה החברה ביום 31.3.2026 (מספר אסמכתא -01-2026-030459).

לפיכך, תוצאות או ביצועים עתידיים בפועל של החברה או החברות המוחזקות שלה עשויים להיות שונים מהותית מכפי שנצפה או כפי שמתפרש במצגת זו.

למעט כפי שיידרש על פי דין, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מצגת זו ו/או לעדכן ו/או לשנות נתונים ו/או תחזיות ו/או הערכות שנכללו בה על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

חלק מהמידע הכלול במצגת (כולל שווקים ומגמות) מבוסס או נגזר מנתונים שהחברה אספה מצדדים שלישיים בלתי תלויים שהחברה אינה יכולה לערוב לנכונותם היות ולא בדקה את הנתונים בעצמה.

כמו כן, מובהר כי אין בביצועי העבר של החברה ו/או החברות המוחזקות שלה המוצגות במצגת זו כדי להוות אינדיקציה לתוצאות העתיד ואין כל וודאות כי החברה ו/או החברות המוחזקות שלה יגיעו לתוצאות דומות או יוכלו ליישם את אסטרטגיית ההשקעה שלהן או להשיג כל יעד השקעה.

מטרת מצגת זו לספק אינפורמציה בלבד בנוגע לחברת פריוורטק בע"מ ("החברה") ו/או החברות המוחזקות שלה.

מצגת זו אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. כמו כן, מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה או איזה מהחברות המוחזקות שלה. המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה.

המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים הפומביים או ככזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים. על כן, מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ובכלל זה, בתשקיף מדף, בדוחותיה העיתיים של החברה או בדיווחיה המיידים של החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה יגבר האמור בדיווחים האמורים.

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים, כוונות ונתונים נוספים המתייחסים לאירועים עתידיים המהווים "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בסעיף 32א בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, המבוסס על תחזיות, ציפיות והנחות סובייקטיביות כפי שידועות לחברה במועד הכנת מצגת זו. ההערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, ויכול שתושפענה מגורמים שאינם בשליטת החברה ושלא ניתן להעריכם מראש באופן סביר במועד, לרבות אבל לא רק, בשל: (א) האטה בצמיחה הכלכלית ככלל והאטה בפעילות בשווקי האלקטרוניקה והשבבים בפרט, עיכובים בשרשרת האספקה ועלויות מחירי הובלה, עלויות במחירי חומרי גלם, הפרעות ועיכובים בהתקנות של המוצרים באתרי לקוחות, עיכובים והפרעות לתהליכי ייצור, שיווק ומחקר ופיתוח, וכן הפרעות ועיכובים בייצוא או ייבוא של רכיבים ומוצרים,

YTD- 25
\$48.8M

Q4-25
\$12.8M

רווחי
אקוויטי

YTD- 25
\$41.5M

Q4-25
\$11.5M

רווח
נקי

חוב פיננסי, נטו
\$50.3M

הון עצמי
\$262M

תחזית שוק הסמיקונדקטור

אנליסטיים מעריכים שתעשיית הסמיקונדקטור תגיע השנה להיקף מכירות של טריליון דולר – רף שבעבר חזו כי יתממש לקראת סוף העשור

המכירות העולמיות בענף הסמיקונדקטור גדלו בשנת 2025 והסתכמו בכ- **792 מיליארד דולר** – גידול של כ- **24%** בהשוואה לשנת 2024. מגמת הגידול צפויה להמשיך בשנת 2026 עם תחזיות של **עד כ- 1 טריליון דולר** מכירות – הקדמה משמעותית של התחזיות שצפו הגעה לרף זה רק לקראת שנת 2030.*

המנוע העיקרי לצמיחה בשוק מגיע מרכיבי Logic ורכיבי זכרון (בעיקר HBM), בעיקר עקב התרחבות השימושים של יישומי AI והדרישה לרכיבי חומרה מתאימים לחוות שרתים ולמחשוב קצה יעודי.

שבבי AI (מאיצים, מעבדים ורכיבי תקשורת) צפויים להוות כ- 50% מכלל מכירות השבבים בעולם, בשנת 2026. כמו כן, צפויה צמיחה בכל האיזורים הגיאוגרפיים ובכל קטגוריות המוצרים.

גורמי הסיכון המשמעותיים הינם עודף כושר ייצור העלול להוביל לירידה במחירים אם הביקוש ייתמתן, הגבלות יצוא, מתיחות פוליטית (בעיקר ארה"ב-סין) ותלות בחומרי גלם.

תיאור המצב העסקי של החברות הכלולות



Camtek
See Beyond

ACCESS



PRIORTECH



 **ACCESS**

AMITEC/ACCESS

 **PRIORTECH**

שנת 2025 הייתה **שנת שיא** של אקסס עם **היקף מכירות שנתי של כ-291 מיליון דולר** לצד שיפור מתמשך ברווחיות במשך השנה. 

אקסס מעריכה כי מגמת הצמיחה תימשך גם בשנת 2026. אקסס מחזקת את מעמדה כיצרון של מודולים לוגיים **למחשבי HPC המיועדים ליישומי AI**.




תחום רכיבי ה-RF
סובל עדיין מהמיתון בסין ומהביקושים הנמוכים לטלפונים סלולריים, אולם רשם שיפור במכירות ועדיין מהווה את **תחום הפעילות העיקרי** האחראי ל-**44%** מהמכירות.



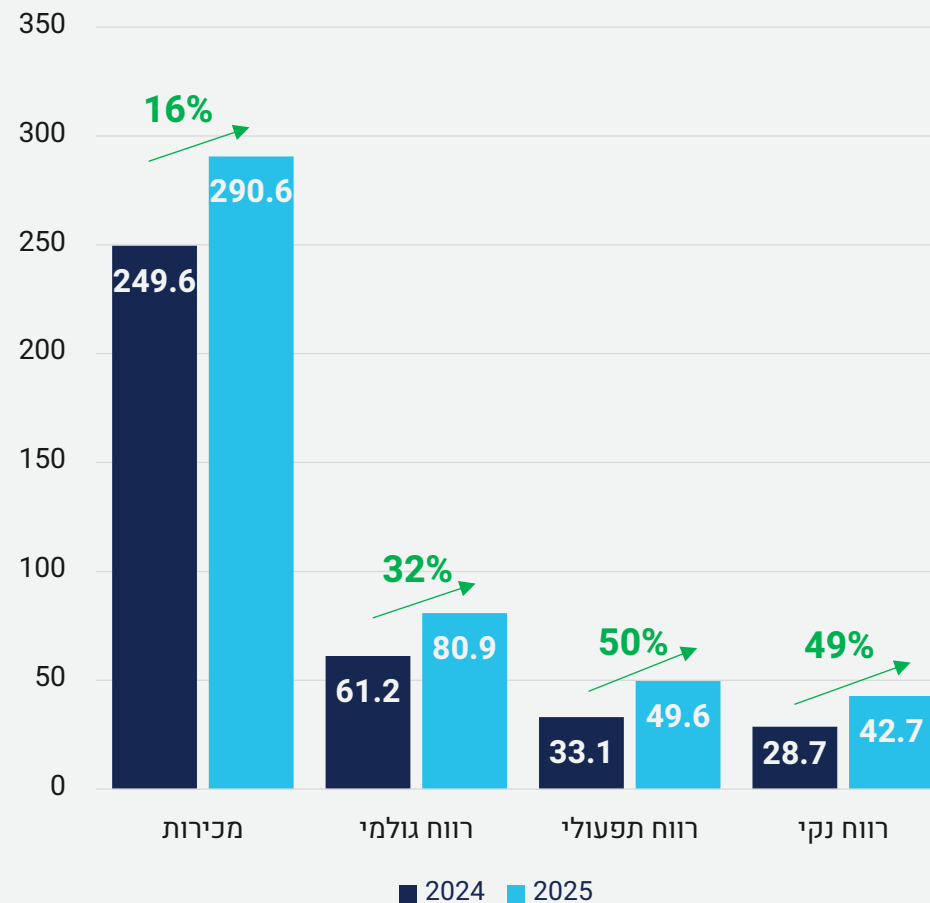
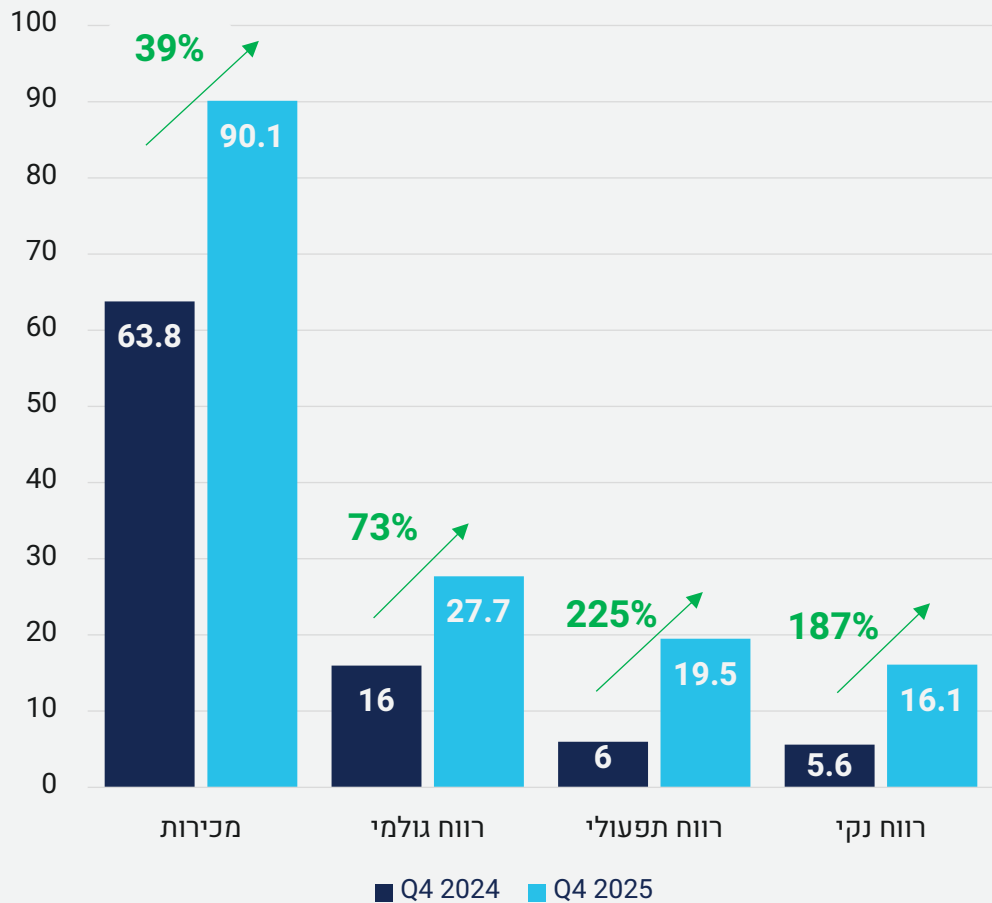
תחום מצעי ה-HPC
עבור יישומי **מטבעות וירטואליים** גדל במחצית השנייה של 2025.



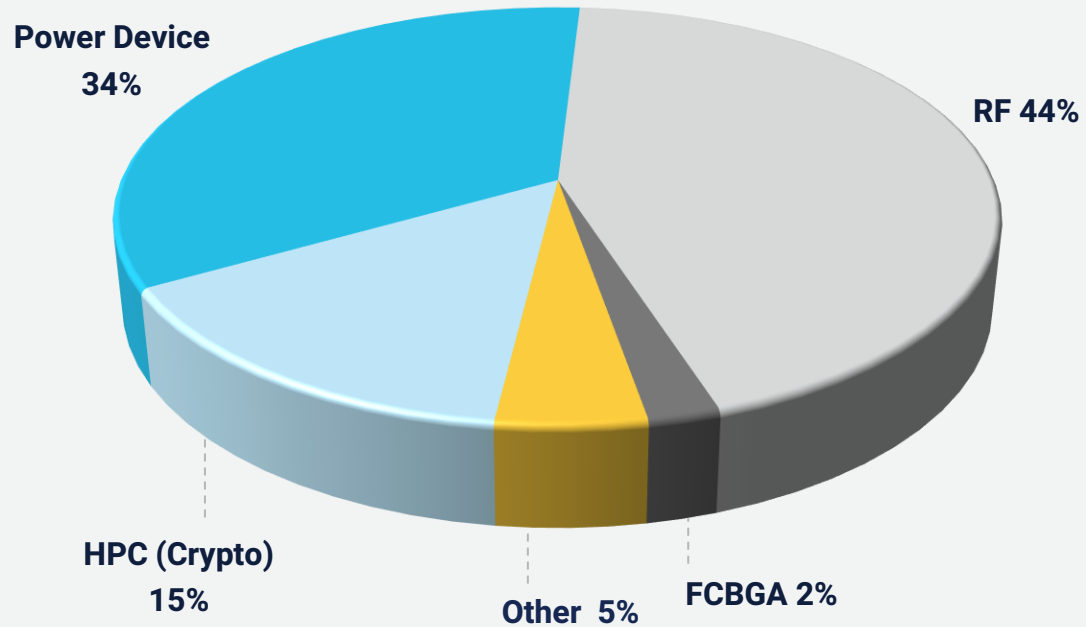
תחום רכיבי ה-Power Device
הפך להיות **תחום משמעותי ומוביל** באקסס, בעיקר בזכות הביקושים לרכיבים המשולבים **במחשבי ה-HPC**, המשמשים בעיקר ב- **Data centers** **וליישומי AI**. תחום זה אחראי ל-**34%** ממכירות אקסס השנה.

בספטמבר 2025, אקסס הגישה את הבקשה לרישום למסחר בבורסה בשנזן, ועברה בדיקת on-site מקיפה של הרגולטור הסיני והיא ממשיכה לפעול לקידום ההליך אל מול רשות ני"ע הסינית והבורסה בשנזן. עדיין לא ניתן להעריך האם ומתי תושלם הנפקתה של אקסס. 

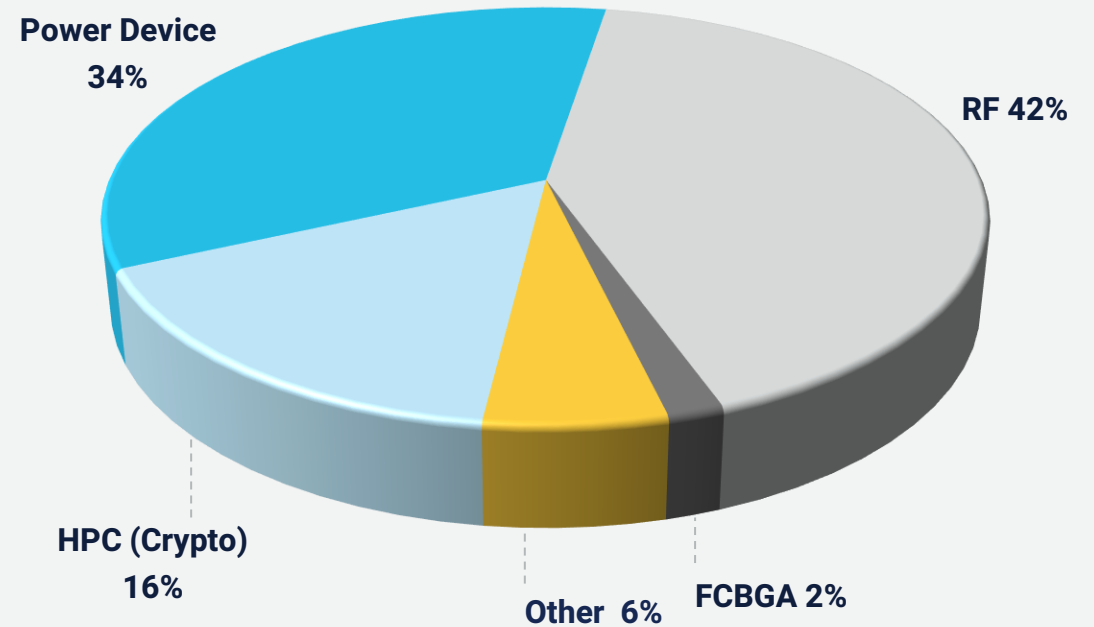




2025 REVENUE



Q4 2025 REVENUE



Camtek



CAMTEK



קמטק צופה שהביקוש בתחום הרכיבים עבור המחשבים עתירי הביצועים ה-**HPC** ימשיך להיות **מנוע הגידול העיקרי** של קמטק. כיום קמטק היא ספק ציוד inspection מוביל בפתרונות לשוק זה.



\$496M **שנת 2025 הסתיימה**
במכירות שיא של כ-

קמטק מחזיקה במעמדה כיצרנית מובילה של מערכות בדיקה למארזים מתקדמים ורכיבים בתחום ה-**HPC**, האחראיות לכ- 45-50% ממכירותיה בשנת 2025. ההערכות בתעשייה הן שקצב הגידול השנתי, בשנים הקרובות, בביקוש לרכיבי HBM ו-Chiplets יהיה דו ספרתי.



\$120M **צפי המכירות**
לרבעון הראשון של
2026 עומד על כ-

המוצרים החדשים של קמטק ה-**Eagle G5** וה-**Hawk** צפויים לתרום כ- 50% מההכנסות של קמטק בשנת 2026. קמטק השקיעה מאמצים מיוחדים בהרחבת יכולות המוצרים החדשים בתחום הבדיקות הדו-ממדיות, ושילבה במנועי הגילוי שלה אלגוריתמים חדשניים מבוססי בינה מלאכותית, ומעריכה כי מאמצים אלו יאפשרו לה לשמור ואף להגדיל את נתח השוק גם בתחום זה.

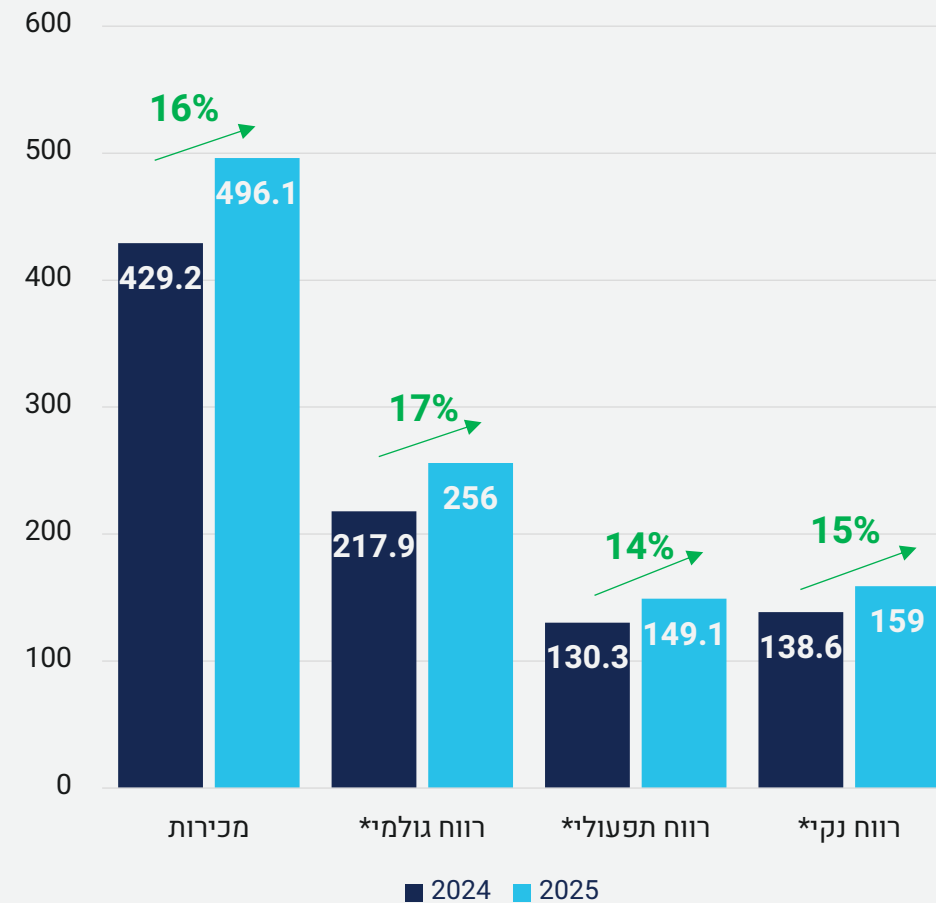
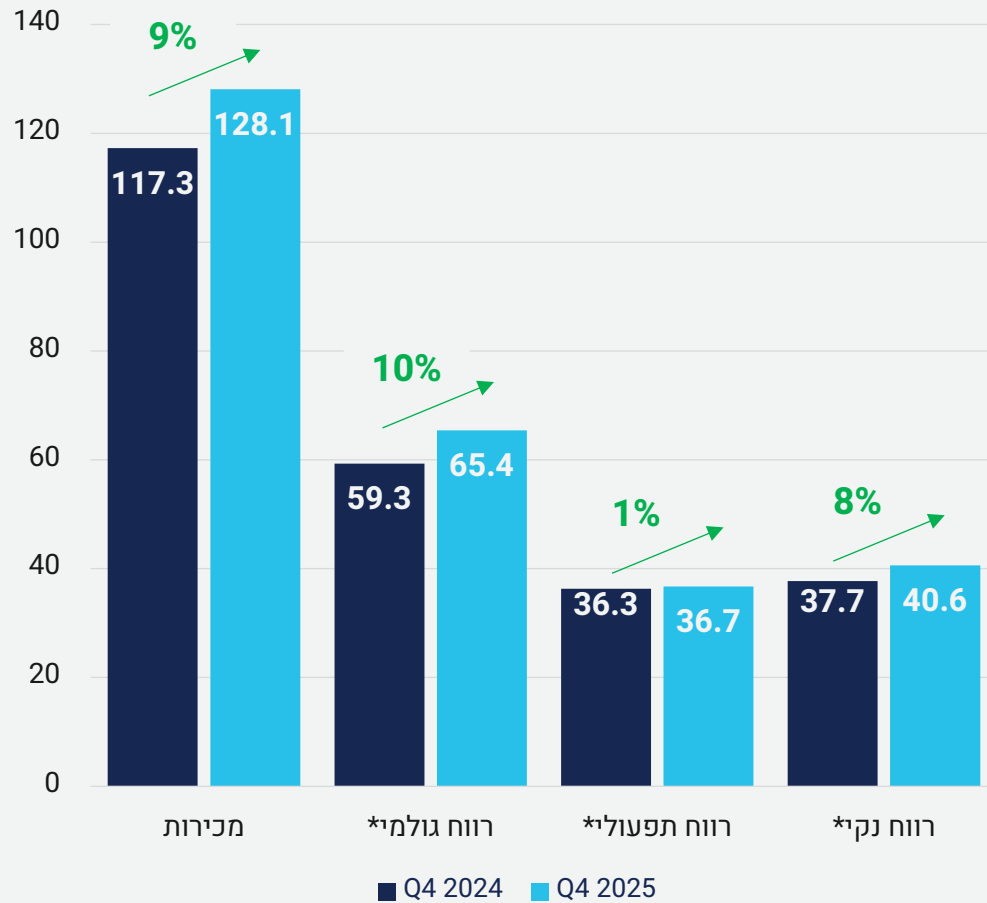


שנת 2026 צפויה להיות שנת צמיחה נוספת - הגידול
בהכנסות צפוי להיות בעיקר במחצית השנייה של השנה



בספטמבר 2025, ביצעה קמטק הנפקת אג"ח מוצלחת בסך 500 מיליון דולר ויתרת הנכסים הפיננסיים שלה עומדת על כ- 851 מיליון דולר ומספקת לה גמישות פיננסית גבוהה להמשיך בצמיחה אורגנית, וכן לבחון הזדמנויות לצמיחה אנאורגנית בשווקים בהם היא פועלת.







קמטק ביססה את מעמדה כמובילה עולמית בתחום בדיקת הרכיבים למחשבים עתירי הביצועים (HPC) המיועדים לאפליקציות AI, אחד התחומים הצומחים והמרתקים בעולם הטכנולוגיה.

קמטק מאמינה שטכנולוגיות המארזים החדשות, Hybrid bonding and micro copper bumps, תהוונה עבור קמטק הזדמנויות צמיחה משמעותיות בשנים הקרובות.



אקסס היא החברה המובילה בסין בתחום המצעים המתקדמים, ומבססת את מעמדה כשחקנית חשובה בייצור מודולים לוגיים לשוק ה-HPC ליישומי AI.

מנוע הצמיחה המרכזי של אקסס הוא תחום המארזים המתקדמים ל-Power Devices (ECP). מארזים אלו מותקנים במחשבי ה-HPC של החברות המובילות בעולם, המשמשים להרצת אפליקציות של AI.



מונחים מקצועיים

הגדרות

(HPC) High Performance Computer

מחשבים חזקים במיוחד כדי לפתור בעיות חישוב מתקדמות, המתבססים על מארזים מתקדמים מסוג Chiplet או Heterogeneous Integration שתומכים בישומי AI וכוללים זיכרונות DRAM מסוג HBM שהם 8 שכבות של ציפים מסוג Dram שמורכבים אחד על השני.



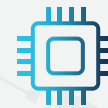
(HI) Heterogeneous Integration

אינטגרציה של רכיבי סמיקונדקטור המיוצרים בנפרד במכלול ברמה גבוהה יותר, אשר, במצטבר, מספקת פונקציונליות משופרת ומאפייני פעולה משופרים.



Chiplet

ציפלט הוא יחידת עיבוד משנית, הנשלטת בדרך כלל על-ידי בקר קלט/פלט הנמצא באותו מארז. ארכיטקטורת הציפלט היא גישה מודולרית לבניית מעבדים. אינטל ו-AMD, יצרני המעבדים המובילים בעולם, מאמצים את ארכיטקטורת הציפלט לקו המוצרים הנוכחי שלהם.



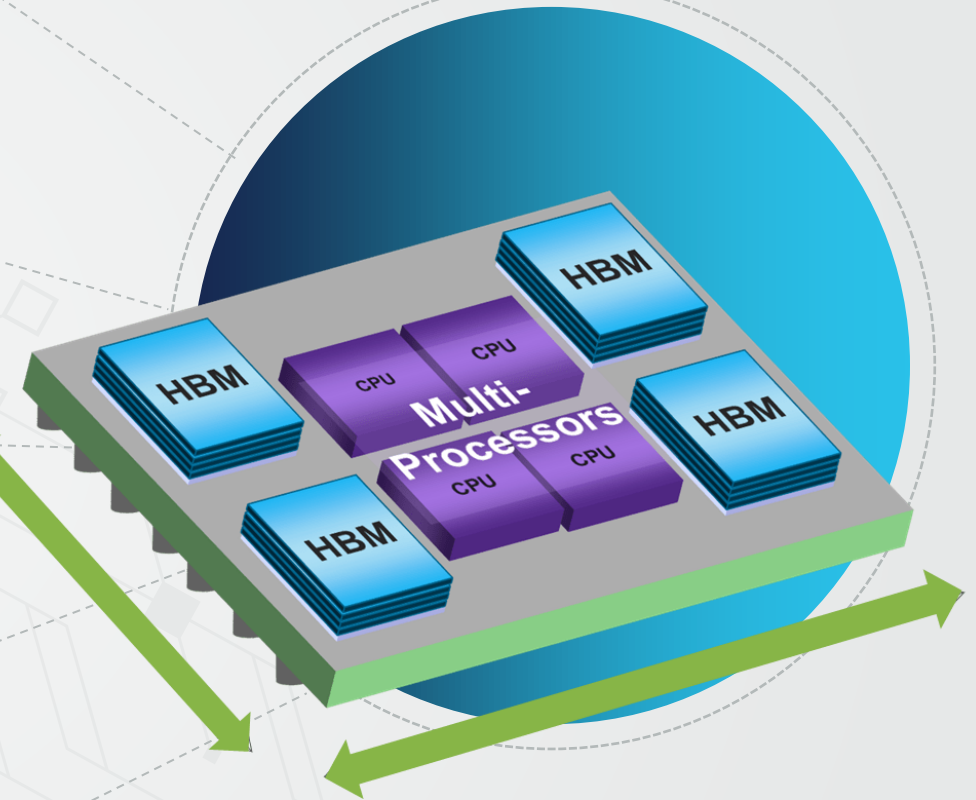
(HBM) High Bandwidth Memories

זיכרון רוחב פס גבוה, הוא ממשק זיכרון מחשב מהיר עבור זיכרון דינמי מוערם בתלת-ממד.



FC-BGA

מערך כדורי על מצע אריזת מוליכים למחצה בצפיפות גבוהה, המאפשר יותר פונקציות לשבבי LSI במהירות גבוהה.



מונחים מקצועיים הגדרות (המשך)



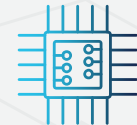
מארזי ECP

מארזים המכילים רכיבים של Power devices שמונחים על מצע אורגני קבור, החיבור בין הרכיבים נעשה על ידי רשת של מוליכים (RDL) במספר שכבות. המארז הוא חלק מסגמנט ה-Advanced Packaging והוא מוגן במספר פטנטים רשומים שאקסס רשמה



RDL

Redistribution layers - רשת של מוליכים דקים בין 2 ל 12 מיקרון שמחברת בין הרכיבים במספר שכבות של הולכה.



Via First

זו הטכנולוגיה הבסיסית שפותחה באמיטק ומיושמת באקסס מיום הקמתה, בטכנולוגיה זו החיבור בין השכבות השונות נעשה דרך pillars שמיושמים בתחילה ורק לאחר מכן מניחים את השכבה, להבדיל מהטכנולוגיה הרגילה בה חורי המעבר (Via) נקדחים ומצופים לאחר הנחת השכבה.



PMIC

Power management Interconnect – רכיבי Power Devices הצורכים זרמים גבוהים ונמצאים בסקלה הגבוהה של המחירים והאיכויות.



Pick&place

טכנולוגיה של השמת רכיבים על מצעים בצורה מאוד מדויקת ובתפוקה גבוהה.

